



journal6 » 2005, Vol. 25 » Issue (5): 29-33

[论文](#)

[本期目录](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#)

[« 前一篇](#) | [后一篇 »](#)

### 用Ti/Cu/Ni中间层二次部分瞬间液相连接Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>陶瓷的研究

邹家生<sup>1,2</sup>, 蒋志国<sup>2</sup>, 初亚杰<sup>2</sup>, 陈铮<sup>2</sup>

- 1. 南京理工大学, 材料科学与工程系, 南京, 210094;
- 2. 江苏科技大学, 材料学院, 江苏, 镇江, 212003

### Study on Double Partial Transient Liquid Phase Bonding with Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> Ceramic Using Ti/Cu/Ni Interlayer

ZOU Jia-sheng<sup>1,2</sup>, JIANG Zhi-guo<sup>2</sup>, CHU Ya-jie<sup>2</sup>, CHEN Zheng<sup>2</sup>

- 1. Department of Materials Science and Engineering, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094, China;
- 2. Jiangsu University of Science and Technology, Jiangsu Zhenjiang 212003, China

[摘要](#)

[图/表](#)

[参考文献](#)

[相关文章 \(15\)](#)

中国航空学会 主办

中航工业北京航空材料研究院 承办

版权所有 © 《航空材料学报》编辑部 总访问量:

地址: 北京81信箱62分箱 邮政编码: 100095

电话: 010-62496277 传真: 010-62456212 E-mail: hkclxb@biam.ac.cn

本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持: support@magtech.com.cn